****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |

**

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Pressemitteilung

Neues congatec COM Express Computer-on-Module
mit 3 GHz Intel® Core™ i3 Prozessor

**Neue kosteneffiziente Einstiegsplattform für das
High-End Embedded Computing**

**Deggendorf, 02. Oktober 2018 \* \* \*** congatec – ein führender Anbieter standardisierter und kundenspezifischer Embedded Computer Boards und Module – stellt mit dem neuen Intel® Core™ i3-8100H Prozessor basierten conga-TS370 Computer-on-Module eine brandneue Preisbrecher-Plattform für das High-End Embedded Computing vor. Diese neue leistungsstarke Plattform besticht durch kosten- und Performance-pro-Watt-optimierten Quad Core Prozessor und energieeffizienten aber durchsatzstarken DDR4 RAM. Mit insgesamt 16 schnellen PCIe Gen 3.0 Lanes ist das Modul perfekt für all die neuen KI- und Machine-Learning-Applikationen, die mehrere GPUs für die parallele Datenverarbeitung benötigen. Die integrierte Intel® HD Graphics UHD 630 ist hinsichtlich Taktrate und Treiber optimiert und bietet so zusätzlichen TDP-Spielraum für noch mehr GPGPU- oder 4k UHD Grafik-Performance. Alle diese Features machen das neue COM Express Basic Computer-on-Module zum Performance-pro-Watt Champion für kostensensitive High-Performance Applikationen, das bei Bedarf auch direkt mit ausgefeilten passiven oder aktiven Kühllösungen ausgeliefert wird.

Typische Anwendungsfälle reichen von vielfältigen vernetzten Embedded-, Industrie- und IoT-Applikationen bis hin zu brandneuen Systemen mit Künstlicher Intelligenz, die alle aktuelle High-End Embedded Performance in einer noch energieeffizienteren Auslegung benötigen, als sie die bislang bereits verfügbaren High-End Intel® Core™ i5 und Core™ i7 Varianten der 8. Generation bieten.

„Der neue 3 GHz Quad Core Intel® Core™ i3 Prozessor und der neue HM370 Platform Controller Hub bieten eine besonders hohe Performance pro Watt und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis“, erklärt Martin Danzer, Direktor Produkt-Management bei congatec. „Durch den deutlich gesunkenen Preis können Kunden nun sogar die rechenintensivsten KI-Applikationen zu einem erschwinglichen Kostenniveau bedienen.“

**Das Featureset im Detail**

Das neue conga-TS370 COM Express Basic Type 6 Computer-on-Module mit Quad Core Intel® Core™ i3 8100H Prozessor bietet eine von 35 W bis 45 Watt konfigurierbare TDP, unterstützt 6 MB Cache und bis zu 32 GB Dual-Channel DDR4 2400 RAM. Die gegenüber der vorherigen 7. Generation der Intel® Core™ Prozessoren verbesserte Speicherbandbreite verhilft der intergierten neuen Intel® UHD630 Grafik auch zu mehr Grafik- und GPGPU-Performance. Zudem bietet sie mit 24 Execution Units auch einen dynamisch gesteuerten, höheren Grafiktakt von bis zu 1,0 GHz. Unterstützt werden bis zu drei unabhängige 4k-Displays mit bis zu 60 Hz via DP 1.4, HDMI, eDP und LVDS. Erstmalig können Entwickler nun auch ohne Hardwareänderungen rein über Softwaremodifikation zwischen eDP und LVDS umschalten. Zudem zeichnen sich die Module durch ihre bandbreitenstarken I/Os aus. Dazu zählen 4x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s), 8x USB 2.0 sowie 1x PEG und 8x PCIe Gen 3.0 Lanes für leistungsfähige Systemerweiterungen einschließlich Intel® Optane™ Memory. Die Module unterstützen alle gängigen Linux Betriebssysteme sowie die 64-bit Versionen von Microsoft Windows 10 und Windows 10 IoT. Der einzigartige persönliche Integrationssupport von congatec rundet das Featureset des neuen Moduls ab. Zudem bietet congatec auch umfangreiches Zubehör und umfassende technische Services, die Kunden eine Integration der neuen Module in ihre spezifischen Lösungen erleichtern.

Das neue Modul ist ab sofort weltweit in der folgenden Standardkonfiguration erhältlich:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores/Threads** |  | **Takt [GHz] (Base/Boost)**  |  | **Cache (MB)**  |  | **GPU Compute Units** |  | **TDP / cTDP [W]**  |
| Intel® Core™ i3-8100H |  | 4 / 4 |  | 3.0 / 2,6 |  | 6 |  | 24 |  | 45 / 35 |

Weitere Informationen zu dem neuen COM Express Type 6 Hochleistungsmodul conga-TS370 unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ6/conga-ts370.html>

**Über congatec**

congatec ist ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und Customizing-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland unterhält Niederlassungen in den USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel, Intel Core und Intel Optane sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*